

**【Causes/processes involved/keys to judgment】**

The defect is caused by the solder ball attached on the solder resist surface by pressure during transportation in HAL process (HAL process)

#### 4-3-2-7 異物起因はんだ濡れ不良／杂物起因の不润湿 / Poor solder wetting by foreign material

**【特徴】** 端子内などで部分的にはんだが付いていない状態の欠陥

**【特征】** 在插脚内等有局部的焊料不粘结的缺陷。

**【Characteristics】** Solder is not coated partially on a land, etc.

**【原因・判断ポイント・発生工程】** はんだ下地に付着した何らかの異物によりはんだ付着が阻害されて出来たもの（HAL前～HAL工程）

**【原因、判断要点、发生工序】** 由于焊料的基底附着某种杂物，妨碍焊料的润湿性所引起的（HAL前～HAL工序）。

**【Causes/processes involved/keys to judgment】**

Solder is not coated partially to the basis metal due to a foreign object attached. (Before HAL - HAL process)



**【コメント】**  
顕微鏡倍率×

**【注釋】**  
显微镜倍率 ×

**【Comments】**  
Magnification: ×



**【コメント】**  
顕微鏡倍率×

**【注釋】**  
显微镜倍率 ×

**【Comments】**  
Magnification: ×

#### 4-3-2-8 端子部はんだ不付き／插脚的焊料不粘结 / No solder on terminal

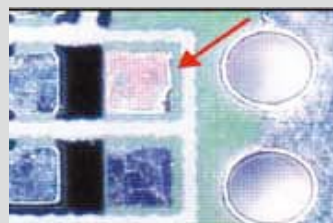
**【特徴】** 幾つも並んでいる端子の一部端子にだけめっきが付いていない状態の欠陥

**【特征】** 在并排的几只插脚的局部有焊料不粘结的缺陷。

**【Characteristics】** Solder is not coated to a part of the terminals formed in a row.

**【原因・判断ポイント・発生工程】** はんだコーティング前の端子の一部に、はんだコーティングを阻害する何らかの異物が付着したことにより出来たもの（HAL前～HAL工程）

**【原因、判断要点、发生工序】** 在热风整平之前，插脚的局部附着某种杂物，妨碍焊料整平所引起的（HAL前～HAL工序）。



**【コメント】**  
顕微鏡倍率×

**【注釋】**  
显微镜倍率 ×

**【Comments】**  
Magnification: ×



**【コメント】**  
顕微鏡倍率×

**【注釋】**  
显微镜倍率 ×

**【Comments】**  
Magnification: ×